

L 90
备案号:88—1997

SJ

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 10705—1996

**半导体器件键合丝表面质量
检验方法**

Standard practice for inspection of surface
quality of semiconductor lead—bonding wire

1996-07-22 发布

1996-11-01 实施

中华人民共和国电子工业部 发布

目 次

1 范围	(1)
2 定义	(1)
3 方法提要	(2)
4 仪器	(2)
5 样品	(2)
6 检验步骤	(2)
7 检验报告	(2)
附录 A(标准的附录) 丝的典型缺陷和无缺陷表面的体视显微镜照片	(4)
附录 B(标准的附录) 丝的典型缺陷和无缺陷表面的扫描电子显微镜照片	(6)

前 言

半导体器件用键合丝是经熔铸、加工、热处理和检验等工序制成的金属或合金细丝。本标准规定的键合丝表面质量检验方法包括体视显微镜法和扫描电镜法。

本标准中的体视显微镜检验方法参照 ASTM F584 - 87(1993 年再次确认)制定,个别参数根据我国实际情况作了变动。为了更准确地判断表面缺陷的性质,增加了扫描电子显微镜/X 射线能谱仪检验方法,供必要时采用。

本标准从 1997 年 11 月 1 日起实施。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准由电子工业部标准化研究所提出并归口。

本标准起草单位:电子工业部第四十六研究所。

本标准主要起草人:齐芸馨、姜春香、段曙光。